

質問

基板の熱そり解析はできますか？

回答

熱応力連成解析で可能です。

基板上に実装した部品が発熱し、その温度分布によって生じる熱ひずみやモデル全体が温度変化した際の熱ひずみの差による基板の変形が解析できます。

温度分布が均一の場合は応力解析単体の熱荷重解析で解析可能です。